

GJB-QR-13-22 工艺总方案

表单编号：XXX

保管期限：年度

项目编号：XXXXXXXX

密级：无

阶段标记：工艺总方案

XXX

年月日

XXXXXXXX 工艺总方案

修订记录：

版本：A/0 第 2 页/共 16 页

修订人：内容：时间：审核：

目录

1.概述

1.1工艺总方案依据、设计原则及执行标准

1.1.1依据

1.1.2 工艺方案设计原则

1.1.3 引用标准

2. 产品的特点、组成及主要工艺技术

2.1 产品特点

2.2 组成

2.3 主要工艺部分

3. 产品工艺流程制造路线及分工

3.1 主要工艺流程

3.2 产品制造分工

3.3 产品工艺分析

概述：

本工艺总方案是为了满足 **XXXXXXXX** 有限公司产品生产需求而制定的。本方案的依据、设计原则及执行标准如下。

工艺总方案依据、设计原则及执行标准：

1.1 依据：

本工艺总方案的依据为 **XXX** 的产品生产需求及相关标准规范。

1.2 工艺方案设计原则：

本工艺总方案的设计原则为安全、高效、环保、经济。

1.3 引用标准：

本工艺总方案所引用的标准有 **XXXX**、**XXXXXX** 等。

产品的特点、组成及主要工艺技术：

2.1 产品特点：

本产品具有 **XXXXXX** 特点。

2.2 组成：

本产品由 **XXXXXX** 组成。

2.3 主要工艺部分：

本产品的主要工艺部分包括 **XXXX**、**XXXX**、**XXXX** 等。

产品工艺流程制造路线及分工：

3.1 主要工艺流程：

本产品的主要工艺流程包括 **XXXX**、**XXXX**、**XXXX** 等。

3.2 产品制造分工：

本产品的制造分工为 XXXX、XXXX、XXXX 等。

3.3 产品工艺分析：

本产品的工艺分析包括 XXXX、XXXX、XXXX 等。

以上为 XXXXXXXX 工艺总方案的内容。

4.3.1 印制电路板的加工工艺

印制电路板是电子产品中必不可少的组成部分。加工工艺的质量直接影响着电子产品的性能和可靠性。印制电路板的加工工艺包括：钻孔、化学镀铜、镀金、覆铜、图形照相、蚀刻、涂覆焊膏等环节。这些工艺的精度和稳定性对于保证印制电路板的质量至关重要。

4.3.2 结构件机加工工艺及表面处理工艺

结构件是电子产品中的另一个重要组成部分。结构件的机加工工艺和表面处理工艺也直接影响着电子产品的质量和外观。机加工工艺包括：车、铣、钻、刨等工艺。表面处理工艺包括：

喷漆、喷粉、阳极氧化等工艺。这些工艺的精度和稳定性对于保证结构件的精度和外观至关重要。

4.3.3 组装、总装和调试工艺分析

组装、总装和调试工艺是将印制电路板和结构件组装成电子产品的重要环节。组装工艺包括：元器件安装、焊接等工艺。总装工艺包括：组装、调试、测试等工艺。调试工艺包括：电气测试、功能测试等工艺。这些工艺的精度和稳定性对于保证电子产品的性能和可靠性至关重要。

4.3.4 包装工艺

包装是保护电子产品的重要手段。包装工艺包括：包装设计、材料选择、封装工艺等环节。这些工艺的精度和稳定性对于保证电子产品的运输和储存至关重要。

4.3.5 “三防”处理

“三防”处理是电子产品中的重要环节，包括防水、防尘、防震。这些处理对于保证电子产品的使用寿命和可靠性至关重要。

5.3.1 模块筛选项目及程序

模块筛选是保证电子产品质量的重要环节。筛选项目包括：外观检查、功能测试、环境适应性测试等。筛选程序包括：初步筛选、终极筛选等。这些筛选的精度和稳定性对于保证电子产品的可靠性至关重要。

5. 产品工艺质量保证措施及特殊安全、环保措施

为了保证电子产品的质量和安全，需要采取一系列的工艺质量保证措施和特殊安全、环保措施。静电防护、零部件防护控制、环境应力筛选等措施对于保证电子产品的质量和安全至关重要。同时，采用环保材料和工艺也是保障环境和人类健康的重要举措。

5.3.2 筛选试验要求

5.3.2. 温度循环缺陷剔除试验

在进行温度循环缺陷剔除试验时，应该按照以下要求进行：

1. 试验参数应该在规定的范围内进行，确保试验结果的可靠性。

2. 试验过程中应该记录下试验数据，以便后续分析。

3. 试验结果应该符合规定的标准，才能通过该项试验。

5.3.2. 温度循环无故障检验试验

在进行温度循环无故障检验试验时，应该按照以下要求进行：

1. 试验应该在规定的温度范围内进行，确保试验结果的可靠性。

2. 试验过程中应该记录下试验数据，以便后续分析。

3.试验结果应该符合规定的标准，才能通过该项试验。

外协加工的项目和要求

在进行外协加工时，应该按照以下要求进行：

1.外协加工的项目应该符合规定的标准，确保产品的质量。

2.外协加工的厂家应该具有相应的资质和经验，确保加工质量。

3.外协加工的过程中应该进行质量检验，确保加工质量符合规定的标准。

4.外协加工的结果应该符合规定的标准，才能使用该产品。

6.1 确定外协件

在确定外协件时，需要考虑供应商的信誉度和技术能力，以确保外协件的质量和可靠性。同时，需要与供应商协商确定交货时间和价格，并签订合同进行管理。

6.2 外协件的检验方式和手段

对于外协件的检验，需要根据不同的外协件类型和要求，制定相应的检验方式和手段。同时，需要建立严格的检验标准和流程，确保外协件的质量符合要求。

7 工艺关键项目及攻关措施、工艺试验项目

7.1 关键工序设置

在制定工艺方案时，需要确定关键工序并制定相应的控制措施。通过对关键工序的控制，可以保证产品的质量和稳定性。

7.2 质控点设置分析

确定相应的质控点。通过对质控点的监控和控制，可以及时发现和处理质量问题，提高产品的质量和可靠性。

7.3 工艺试验项目

在制定工艺方案时，需要根据产品特点和工艺要求，确定相应的工艺试验项目。通过工艺试验，可以验证工艺方案的可行性和稳定性，为后续的生产提供依据。

8 采用新技术、新材料、新工艺情况

在生产过程中，如果采用了新技术、新材料或新工艺，需要对其进行充分的评估和试验，确保其可靠性和稳定性。同时，需要制定相应的控制措施，对其进行严格的监控和管理。

9 首件鉴定项目及实施要求

符合要求。同时，需要制定相应的实施要求和流程，确保首件鉴定的有效性和可靠性。

10 工艺装备、试验和检测设备的选择

10.1 工艺装备要求

在选择工艺装备时，需要考虑其适用性和可靠性。同时，需要对工艺装备进行充分的评估和试验，确保其能够满足生产要求。

10.2 试验设备的要求如下：

在选择试验设备时，需要根据试验项目和要求，确定相应的设备和方法。同时，需要对试验设备进行充分的评估和试验，确保其能够满足试验要求。

11 制造过程中产品技术状态的控制要求

管理。通过对生产过程的监控和控制，可以确保产品的质量和稳定性。

12 工艺标准化要求

在制定工艺方案时，需要遵循相应的标准和规范，确保工艺方案的合理性和可行性。同时，需要对工艺标准进行动态管理和更新，以适应生产的需求。

13 工艺准备过程中形成的文件和具体要求

在工艺准备过程中，需要制定相应的文件和具体要求，以确保工艺准备的有效性和可靠性。同时，需要对文件和要求进行管理和更新，以适应生产的需求。

14 工艺总方案的动态管理情况

以适应生产的需求和变化。同时，需要对工艺总方案进行评估和改进，以提高生产效率和质量。

制造路线及分工

本产品的主要工艺流程制造路线如下：

- 1)印制板表面组装工艺流程；
- 2)军用电子设备电气装配工艺流程；
- 3)生产环境的静电防护工艺流程；
- 4)军用装备环境应力筛选工艺流程。

4.2 分工

- 1)印制板表面组装工艺流程：由 PCB 制造厂家完成；
- 2)军用电子设备电气装配工艺流程：由装配厂家完成；
- 3)生产环境的静电防护工艺流程：由生产厂家完成；
- 4)军用装备环境应力筛选工艺流程：由测试厂家完成。

5 工艺控制

5.1 工艺控制点

本产品的工艺控制点主要包括：

- 1)印制板表面组装过程中的焊盘质量、元器件质量、焊接质量等；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505331303341011334>